969973-3 ✔ 有效

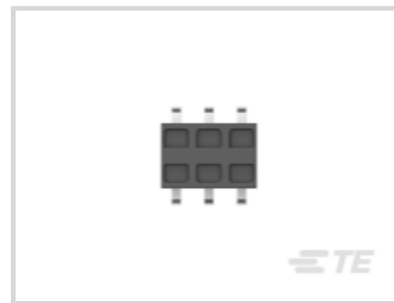
AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

TE 内部编号 969973-3

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: **板对板**

位数: 6

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	6
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 µm[98.42 µin]
端子布局	直插式
接合插针直径	.63 mm[.025 in]
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	.762 µm[30 µin]
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

堆叠高度	9 mm[.354 in]
连接器高度	6.2 mm[.244 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	600
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

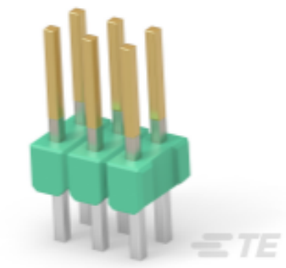
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 826634-3
AMPMODU MOD II PIN HEADER

TE 产品编号 966709-3
2X3P MODUII BREAK AWAY HEADER, SMD

TE 产品编号 826658-3
3P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826632-3
3P AMPMODU II PIN HDR.

TE 产品编号 826656-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER

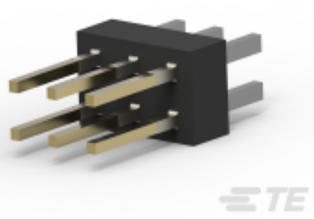
TE 产品编号 826662-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 829394-3
2X3P MOD II UNSHRD HDR, ST, 0.8 AU

TE 产品编号 826664-3
3P MOD2 STIFT LEI

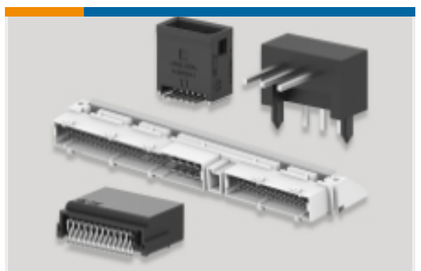
TE 产品编号 828132-3
3P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号 966269-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, TUBE PKG



TE 产品编号 215447-3
2X 3P MOD2 STIFTLEI

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190



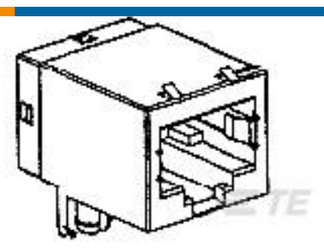
PCB 板端连接器及母端(333)

客户还购买了

TE 产品编号292173-3
CT BOX HDR H SMT 3P O/TAPE BLA

TE 产品编号2173157-3
MICRO USB, TYPE B, SPLASHPROOF (LOW MOQ)

TE 产品编号5520258-2
MJ,TE,6P/4C,PNL STOPS,TRAY P



TE 产品编号5558341-1
MJ,8POS,R/A,CAT 5e

TE 产品编号5569284-1
MJ,TE,8P

TE 产品编号5558872-1
MJ,TE,4P,W/0 PNL STOPS

TE 产品编号1827625-1
SHIELD FINGER 3014 ANTI OVER STRESS TYPE

TE 产品编号225616-E
M12 FEMALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT

TE 产品编号1393236-9
V23092-A1012-A303

TE 产品编号3004237-F
ZA009102; LMx Manifold incl. 2 x-rings

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_969973-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。